

皮秒精密激光切割机

PICOSECOND PRECISION LASER CUTTING MACHINE

微电子精密切割

最小切割线宽小于5μm

视觉自动定位

自动定位方向和位置
精度高达±5μm

搭载防震平台

Akribis高精度直线电机运动平台
结合大理石防震平台



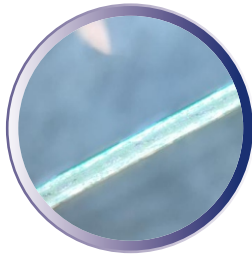
产品概述 / Product Overview

设备搭载智能定位系统，自动识别位置和方向，精度高达±5μm;配备Akribis高配精度直线电机运动平台配合大理石防震平台，结合超短脉冲激光技术及实时检测系统，确保高度、速度、精度达到最佳状态。

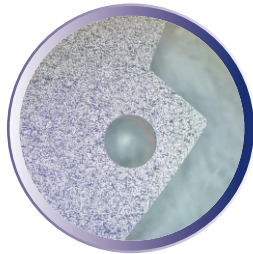
应用领域 / Application Fields

皮秒精密激光切割机广泛应用于3C微电子、医疗器械、光伏能源、汽车零部件等高端制造领域。

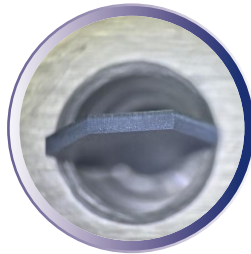
样品展示 / Sample Showcase



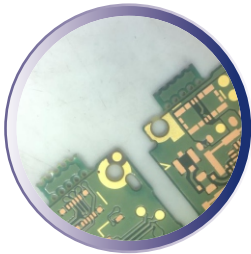
晶圆激光切割



陶瓷激光切割



硅基材料激光切割



PCB板激光穿孔

产品优势 / Product Advantages

- 搭载自动定位系统，实现定位位置和方向，精度高达±5μm；
- Akribis高精度直线电机运动平台结合大理石整体设计防震平台，确保高速度、高精度、高良率；
- 自研专业切割软件，可直接导入CAD制作的DXF图形，精确按照输入图形切割，所见即所得；
- 光路部分优化设计后，可实现同等功率下速度、效果最优化，同时进行高效防尘处理，有效减少设备停机清洁维护周期，减少粉尘对产品造成的潜在损害。

技术参数 / Technical Specifications

设备型号	IT-LCP-CD50、IT-LCP-CD100
激光功率	50W/100W
平台精度	重复≤2μm，定位≤5μm
CCD定位精度	±3μm @200万像素
最小切割线宽	< 5μm
脉宽	15ps
温度要求	15-25℃
湿度要求	< 60%